

Water-soluble Additive StayClean -F

切割加工中防止接线头腐蚀

防止接线头腐蚀

大口径，小晶粒晶粒在加工时，由于工作物与切削水之间长时间接触，接线头有时会被腐蚀。在切削水中添加 StayClean-F，能够在工作物的表面形成超薄的保护层，有效地防止接线头腐蚀。

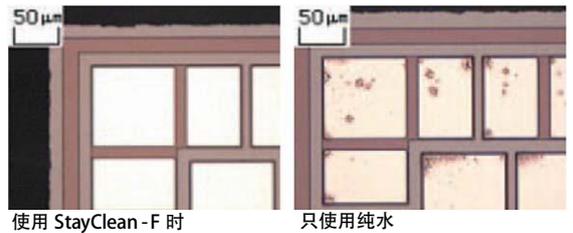
防止接线头腐蚀 现有离心清洗无法完全除净的微粒，也可通过在切削水中添加 StayClean-F，促使其脱离工作物表面，防止微粒污染。

无RoHS物质·低运行成本

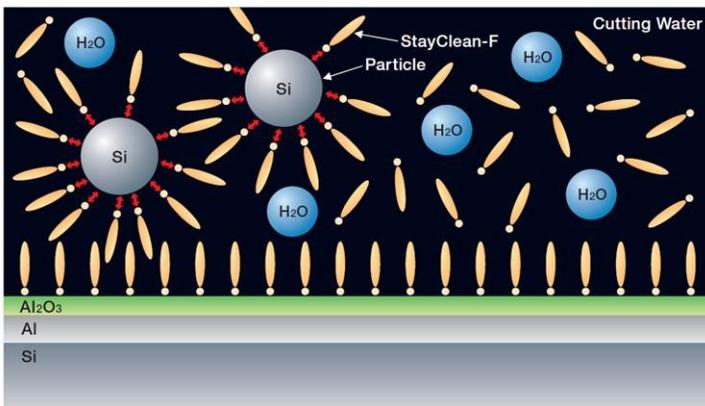
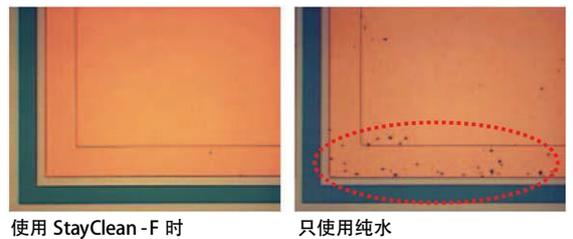
StayClean-F 不含有任何 RoHS 物质及 PFOS 等限制类化学物质，可在正常切割条件※下使用。同时，即使稀释到数千分之一，甚至为防止腐蚀而稀释到数万分之一，仍然可以有效地发挥防污效果，实现低成本运行。

※需循环使用时，请向迪思科销售部分咨询。

防接线头腐蚀效果比较



防污效果比较



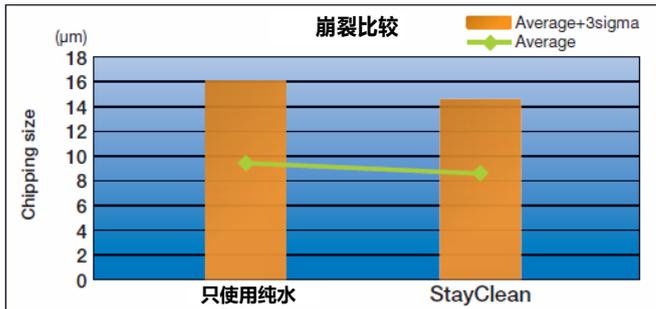
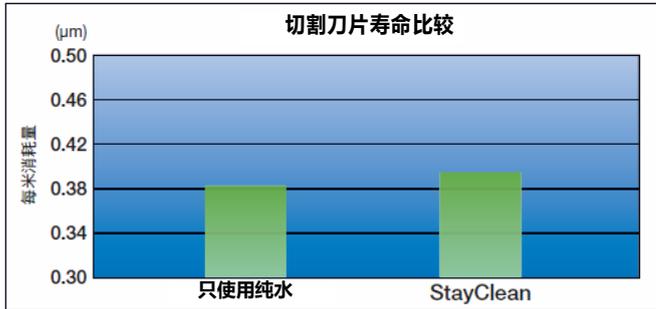
原理

- ① StayClean-F 中的成分在工作物表面形成保护层，有效地防止接线头腐蚀及微粒污染。
- ② 在离心清洗时，同时清除 StayClean-F 成分。



保持同样的加工结果

即使添加 StayClean-F、也能够保持通常使用纯水时的加工结果。



Workpiece : Si wafer Spindle rpm : 40,000 (min⁻¹)
Blade : NBC-ZH Feed speed : 60 mm/s

StayClean-F 技术规格

StayClean-F		
原液外观	-	无色透明液体
主成分	-	水溶性高聚物
pH (原液)	pH	4.7 密度
(15 °C)	g/cm ³	1.03
分解性	mg/L	COD 32 (JIS K0102-17)
(0.1 %时)	mg/L	BOD 2.5 (JIS K0102-21) 稀
释比率	倍	1,000 - 10,000 (0.1~0.01 %)

StayClean 注入器

电源、电压	V	AC90 - 230 单相 50/60 Hz
入口水温	deg C	20 - 25
入口水压	Mpa	0.2 - 0.5
对应水流量	L/min	2 - 20
原液 注入率	%	0.1 - 0.01 (1,000 - 100 ppm)
装置尺寸 (W x D x H)	mm	注入器 200 x 300 x 500 不包括突起部分 储瓶器 357 x 392 x 440 不包括突起部分
装置重量	kg	注入器 约 22 (无水时)

■注意事项

使用前

- 产品安全技术说明书 (MSDS) 中详细记载了相关注意事项, 因此在使用 StayClean-F 之前, 请务必仔细阅读。
- 请不要用于其它用途。

使用时

- 请使用合适的防护眼镜、手套, 避免药液接触眼睛, 皮肤。
- 请勿与其它的化学品 (特别是强酸、强碱性的化学品) 同时使用。

保管时

- 请于阴暗场所保管, 避免直射阳光, 但不要放入冷冻库。
- 请保持密封。
- 在密封状态下, 质量保证期间为, 从生产日期起 1 年。

StayClean 注入器

使用专门开发的 StayClean 注入器, 可以保证低浓度切削液的安定供给。

